



보도자료

EV Group, 양산용 차세대 EVG®120 레지스트 공정 시스템 공개

새로운 초소형 플랫폼, 더 작은 풋프린트에 인-시투 레지스트 두께 계측과 웨이퍼 엣지 노광 기능 및 EVG150 급 성능을 구현하고, 보다 유연한 모듈 구성 지원

2026년 2월 19일 – 첨단 반도체 설계 및 칩 통합 방식에 대한 혁신적인 공정 솔루션과 전문성을 제공하는 선도 기업인 EV Group(이하 EVG)은 자사의 대표적인 코터/디벨로퍼(coater/developer, 도포/현상) 플랫폼 중 하나에 대한 주요 업데이트인 차세대 EVG®120 자동 레지스트 공정 시스템을 공개했다. 새로운 EVG120은 콤팩트한 신규 아키텍처, 획기적인 기능, 그리고 널리 채택된 EVG150 시스템에서 검증된 향상된 설계 요소들을 통합함으로써 이전 세대 장비에 비해 크게 향상된 처리량, 더 높은 유연성, 개선된 공정 제어 성능을 제공한다. 이 모든 성능과 기능들은 다양한 제품과 레지스트 공정을 복합적으로 사용하기 때문에 고도의 유연성을 필요로 하는 고객들에게 최적화된 소형 풋프린트 상에서 제공된다.

차세대 EVG120은 첨단 패키징, MEMS, 이미지 센서, 포토닉스, 전력 반도체, 웨이퍼 프로브 카드, 기타 급성장 중인 응용 분야에 이상적인 솔루션으로서, 포토리소그래피에 사용되는 포토레지스트의 스핀 코팅, 스프레이 코팅 및 디벨로핑 공정을 지원한다. 또한 이 장비는 2인치부터 최대 200mm까지 다양한 크기와 유형의 기판을 처리할 수 있으며, 박막·후막 레지스트, 포지티브 톤 및 네거티브 톤 레지스트, PI 및 PBO와 같은 절연 소재, 그리고 특수 애플리케이션을 위한 블랙/컬러/IR 레지스트 등 폭넓은 레지스트 소재를 지원한다.

새로운 플랫폼과 확장된 기능

EVG120은 최대 2개의 습식 공정 모듈과 14개의 베이크/칠 플레이트를 통합한 콤팩트한 200mm 플랫폼을 기반으로 재설계되었으며, 이로써 이전 세대 플랫폼에 비해 처리 용량이 40% 증가했다. 시스템의 설치 면적은 20% 이상 축소됐으며, 설계 향상을 통해 장비 유지보수 접근성이 향상되고 유연한 모듈형 구성도 가능해졌다.

또한 이 시스템은 이전 세대 장비에서는 제공되지 않았던 다음과 같은 몇 가지 신규 기능들이 추가됐다:

- **웨이퍼 엣지 노광(Wafer Edge Exposure, WEE):** 선택적 엣지 노광을 통해 웨이퍼 엣지의 정밀도 및 균일성 향상

- **인-시투 레지스트 두께 측정(In-situ Resist Thickness Measurement):** 실시간 공정 모니터링을 통해 수율 및 공정 제어 향상 (측정 범위: 50nm ~ 50µm)
- **향상된 고점도 디스펜스 시스템:** 페루프 피드백 기반의 고압 디스펜싱으로 후막 포토레지스트에서 정밀한 코팅 성능 제공
- **SMIF 로드포트(loadport) 지원:** 보다 청정하고 효율적인 소재 핸들링 구현
- **대기 모드(Stand-by Mode):** 비가동 시간(idle period) 동안 에너지 소비를 줄이며, SEMI E167 규격 지원

이 새로운 기능들은 EVG의 검증된 코팅 기술들을 기반으로 한다. 여기에는 우수한 균일도를 제공하고 소재 사용을 줄이는 혁신적인 CoverSpin™ 볼(bowl) 설계와, 심한 단차 구조나 깨지기 쉬운 기판에서도 최적의 표면 코팅을 가능하게 하는 독자적인 OmniSpray® 컨포멀 스프레이 코팅 기술이 포함된다.

EVG의 기업 기술 디렉터인 토마스 글린스너 박사(Dr. Thomas Glinsner)는 “차세대 EVG120 플랫폼은 EVG가 지난 수십 년간 포토레지스트 및 리소그래피 공정 분야에서 축적해 온 풍부한 경험을 바탕으로, 연구개발 단계부터 양산 단계에 이르기까지 널리 분포해 있는 고객들의 다양한 요구를 지원하도록 설계되었다”며, “인-시투 계측이나 웨이퍼 엣지 노광과 같은 새로운 기능은 물론, EVG150 플랫폼에서 계승된 다양한 기능들을 포함하고 있는 EVG120은 콤팩트하면서도 양산에 즉시 적용 가능한 플랫폼을 통해 코팅 및 디벨로핑 성능, 처리량, 유연성, 총소유비용(TCO) 측면에서 최상의 조합을 제공한다”고 말했다.

제품 공급 현황

EVG는 현재 차세대 EVG120 시스템에 대한 주문을 접수 중이다. 장비 시연은 EVG 본사에서 제공되며, 자세한 정보는 웹사이트 <https://www.evgroup.com/products/lithography/resist-processing-systems/evg120>에서 확인할 수 있다.

EV Group(EVG) 소개

EV Group(EVG)은 첨단 반도체 설계 및 칩 통합 방식을 위한 혁신적인 공정 솔루션과 전문성을 제공하는 글로벌 선도 기업이다. EVG는 가장 먼저 새로운 기술을 탐색하고 마이크로·및 나노 제조 기술의 차세대 응용 분야를 지원한다는 비전을 바탕으로, 고객이 새로운 제품 기획을 성공적으로 상용화할 수 있도록 돕고 있다. 웨이퍼 본딩, 리소그래피, 초박형 웨이퍼 처리 및 계측 장비를 포함한 EVG의 양산 지원 제품군은 반도체 프런트엔드 스케일링, 3D 집적 및 첨단 패키징뿐만 아니라 기타 전자 및 광학 애플리케이션의 발전을 지원한다. EVG에 대한 보다 자세한 정보는 www.EVGroup.com에서 확인할 수 있다.

보도자료 문의:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

EVG 코리아 문의

EV Group Korea Ltd.
Tel: 02-3218-4413
E-mail: Sales@EVGroup.co.kr

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-mail: dmoreno@openskypr.com

박윤희 실장

페리엔
Tel: 02-565-6625
E-mail: desiree@perrien.co.kr

###